

「エレクトロニクス開発・実装展」に出展

株式会社東海理化(本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之タ 裕美)は、9月17日(水)から9月19日(金)まで幕張メッセにて開催される「エレクトロニクス開発・実装展」(第4回ネブコン ジャパン 秋- エレクトロニクス開発・実装展)に出展します。

当社は「人が手掛けないことこそやる」の創業精神のもと、自動車部品業界で培われた技術で事業を拡大してきました。自動車部品に組み込む半導体は自社工場で累計 5.5 億個の生産実績があり、2023 年度からは半導体外販*も進めております。今回の展示ではその取り組みに加え、カーボンナノチューブを用いた熱電発電モジュールなど、エネルギー分野への応用を目指した新技術もご紹介します。

※中期経営計画目標の実現と、将来の成長に向けた挑戦を加速させる『未来創造投資』案件の一つ

◇主な展示品

・磁気センサ製品

自社工場で製造したAMRセンサを搭載した回転角センサ、近接センサを展示。これらは自社の自動車部品に組み込まれる形で使用されている高精度・高信頼性のセンサです。

・カスタムIC製品

お客様のニーズに合わせてカスタムICの設計・製造が可能。アナログ・デジタル・ミックスドシグナルと幅広いICに対応可能。また、センサ信号を増幅・処理するためのAFE ICやモータ・LEDを駆動するドライバICの経験が豊富です。

⇒ [センサ製品・カスタムICの紹介パネル](#)

・熱電発電モジュールと温度センサ

お客様のニーズに応じて可変・出力調整可能であるカーボンナノチューブを用いた熱電発電モジュールを展示。また、本技術を応用した温度センサ、電磁波シールド部材などのご提案も可能です。

⇒ [カーボンナノチューブ紹介パネル](#)

◇出展場所

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）ホール 2 小間番号 7-1

⇒ [会場地図](#)



◇来場登録サイト

<https://www.nepconjapan.jp>

※来場には来場事前 登録（無料）が必要になります。来場登録は上記 URL より申し込みください。

【半導体 URL】 <https://tr-semicon.tokai-rika.co.jp/>

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社東海理化 総務部広報室（0587-95-5211）